

2017 年 1 月 23 日

お客様各位

東京エレクトロデバイス株式会社
インレビウムカンパニー
設計開発センター
品質管理部
部長 矢島 道則

TE7760PF 製造拠点変更および材料変更について

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、貴社にてご採用いただいております Inrevium 製品に関して、以下の通り変更通知のご連絡を申し上げます。
大変お手数ではございますが内容をご確認の上、返却用紙にご承認印を押印後、弊社までご返却いただきますようお願い申し上げます。

敬具

—記—

対象型格
変更内容

TE7760PF
生産拠点変更および材料変更

■ 生産拠点

< 変更前 >

ジェイデバイス宮城工場 (BSG ~ 組立)

ジェイデバイス会津工場 (試験)

< 変更後 >

ジェイデバイス臼杵, 杵築工場 (BSG+DIC)

ジェイデバイス福岡工場 (DB 以降)

■ 材料変更

項目	変更前	変更後
ワイヤ	Au (コーティング無)	Cu (Pd コート有)
モールド樹脂	A (詳細は社外秘)	B (詳細は社外秘)
半田めっき	Sn-Bi	Pure Sn

・上記材料すべて、RoHS、Reach 対応品です。

・ワイヤ、半田めっきについて

材料系が変更されますが求められる性能は同等です。

・モールド樹脂について

材料型番などの詳細は社外秘となっておりますが現行品

と同じ材料系 (エポキシ) のハロゲン非含有タイプを適用、

難燃性は UL 規格 94V-0 に準拠しております。

変更理由

製造委託先である株式会社ジェイデバイスの経営効率の改善および
標準材料を適用し、生産性の向上を図るため

移管予定時期

2017 年 6 月以降

* 5M 変化点

5M1E	変化点
Man (人)	(宮城・会津) 作業者 BSG+DIC(臼杵) (杵築) DB 以降(福岡) 作業者 同等の教育を受けた作業者が従事致します。
Machine (装置)	同等又は上位互換の機種の使用致します。
Measurement (測定方法)	同等又は上位互換の測定機の使用致します。
Method (方法)	同一製造フロー・管理で製造致します。
Material (材料)	* 以下の材料変更を行います。 ワイヤ / モールド樹脂 / めっき
Environment (環境)	(宮城・会津) BSG+DIC(臼杵), (杵築) DB 以降(福岡) 他半導体製造で実績のある同等環境で製造致します。

* バックグラインド (BSG) / ダイシング (DIC) / ダイボンディング (DB)

貴社受領印欄	
日付:	_____
貴社名:	_____
部署名:	_____
ご署名:	_____ 印

東京エレクトロンデバイス株式会社
品質管理部